香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION 中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號:981)

內幕消息 關於簽訂臨港合作框架協議的公告

中芯國際集成電路製造有限公司(「**中芯國際**」或「**本公司**」, 連同其子公司統稱「**中芯國際 集團**」) 根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部的內幕消息條文和香港上市規則第13.09(2)(a)條發出本公告。

合作框架協議

本公司欣然宣佈,本公司於2021年9月2日和中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會(「上海自貿試驗區臨港新片區管委會」)簽署合作框架協議。

根據合作框架協議,本公司和上海自貿試驗區臨港新片區管委會有意在上海臨港自由貿易試驗區(「**臨港自由貿易區**」)共同成立合資公司(「**該合資公司**」),該合資公司將規劃建設產能為10萬片/月的12英吋晶圓代工生產線項目(「**該項目**」),聚焦於提供28納米及以上技術節點的集成電路晶圓代工與技術服務。

該項目計劃投資約88.7億美元,該合資公司註冊資本金擬為55億美元,其中本公司擬出資佔比不低於51%,上海市人民政府指定的投資主體擬出資佔比不超過25%。本公司與上海自貿試驗區臨港新片區管委會將共同推動第三方投資者完成剩餘出資,後續根據第三方投資者出資情況對各自出資額度及股權比例進行調整。本公司將負責該合資公司的營運及管理。

本公司和上海自貿試驗區臨港新片區管委員會已同意進行真誠磋商,以就成立該合資公司簽訂最終協議。

本合作框架協議自簽字蓋章之日起成立,在約定條件滿足後生效。

訂約方資料

本公司

本公司及其子公司,是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一,也是中國內地技術最先進、配套最完善、規模最大、跨國經營的集成電路製造企業集團。中芯國際集團提供0.35微米到14納米不同技術節點的晶圓代工與技術服務。中芯國際集團總部位於上海,擁有全球化的製造和服務基地。中芯國際在中國上海建有一座200mm晶圓廠,以及一座擁有實際控制權的300mm先進製程合資晶圓廠;在北京建有一座300mm晶圓廠和一座控股的300mm晶圓廠;在天津和深圳各建有一座200mm晶圓廠。中芯國際集團還在美國、歐洲、日本和中國台灣設立營銷辦事處、提供客戶服務,同時在中國香港設立了代表處。

上海自貿試驗區臨港新片區管委會

上海自貿試驗區臨港新片區管委會成立於2019年8月,系上海市人民政府的直接派出機構。上海自貿試驗區臨港新片區管委會負責落實上海自貿試驗區臨港新片區的各項改革試點任務,以及區內投資、貿易、金融服務及資源規劃的管理工作。強化全球高端資源配置核心功能、更好代表中國參與和融入經濟全球化是上海自貿試驗區臨港新片區的重要職責。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉和確信,上海自貿試驗區臨港新片區管委會 及其最終實益擁有人為本公司及其關連人士(定義見香港上市規則)的獨立第三方。

訂立合作框架協議的理由

通過把握臨港自由貿易區發展集成電路行業的戰略機遇期,該項目將滿足不斷增長的市場和客戶需求,推動本公司業務發展。

本公司認為該項目有利於促進本公司擴展生產規模和提升納米技術服務,從而獲得更高回報。

綜上所述,本公司認為訂立合作框架協議符合本公司和其股東的整體利益。

一般事項

合作框架協議可能但未必致使訂立最終協議且據此擬進行的交易亦可能但未必會進行。 根據香港上市規則,該項目倘獲落實,或會構成本公司的須予公佈交易。本公司將遵守 有關該項目的適用香港上市規則。本公司將根據香港上市規則的要求適時發出進一步公 告。

本公司股東和潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

釋義

於本公告內,除文義另有所指外,下列詞彙具有以下涵義:

「董事會」 指 董事會

「本公司」 指 Semiconductor Manufacturing International Corporation(中

芯國際集成電路製造有限公司*),一家於開曼群島註冊成立的有限公司,其股份於香港聯交易所主板及上海證

券交易所科創板上市

「合作框架協議」 指 本公司與上海自貿試驗區臨港新片區管委會就(其中包

括)該項目訂立的合作框架協議

「董事」 指 本公司董事

「香港」 指 中國香港特別行政區

「香港上市規則」 指 香港聯交所證券上市規則

「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「中國 指 中華人民共和國

「美元」 指 美元,美利堅合眾國法定貨幣

指 百分比

承董事會命 中**芯國際集成電路製造有限公司** 執行董事、首席財務官兼公司秘書 高永崗

中國上海 2021年9月3日

於本公告日期,董事分別為:

執行董事

周子學(董事長) 蔣尚義(副董事長) 趙海軍(聯合首席執行官) 梁孟松(聯合首席執行官) 高永崗(首席財務官兼公司秘書)

非執行董事

魯國慶

陳山枝

黄登山

任凱

周杰

獨立非執行董事

William Tudor BROWN

劉遵義

范仁達

楊光磊

劉明

* 僅供識別